



ソリッドステートストレージ商品カタログ

購入問合せe-mail: contact@karotech.co.jp

目次

1. Storage Controller / ストレージコントローラー

1.1 SATA Controller / SATAコントローラー

- 2.1.1 XT6110
- 2.1.2 XT6120
- 2.2.3 XT6121
- 2.2.4 XT6160

1.2 PCIe Controller / PCIeコントローラー

- 2.2.1 XT8111
- 2.2.2 XT8210
- 2.2.3 XT8211
- 2.2.3 XT8310

1.3 eMMC Controller / eMMCコントローラー

- 2.3.1 XT5521

2. Solid State Drive / ソリッドステートドライブ

2.1 Industrial-Grade SATA / SSD産業グレード SATA SSD

- 3.1.1 DS1000
- 3.1.2 DS1200Pro
- 3.1.3 DS2200 (標準温度範囲)
- 3.1.4 DS2200 (広温度範囲)
- 3.1.5 DS2130
- 3.1.6 DS2140

2.2 Enterprise-Grade SATA SSD / エンタープライズグレードのSATA SSD

- 3.2.4 SS2000SE
- 3.2.5 SS6000SE

2.3 Industrial-Grade PCIe SSD / 産業グレードのPCIe SSD

- 3.3.1DP2100
- 3.3.1DP2100HE

2.4 Enterprise-Grade PCIe SSD / エンタープライズグレードのPCIe SSD

- 3.4.1 SP5000

2.5 Consumer-Grade PCIe SSD / コンシューマーグレードのPCIe SSD

- 3.5.1 EP2000Pro
- 3.5.2 EP3000

3. Embedded Storage / 組み込みストレージ

3.1 eMMC

- 4.1.1 E110-X0I (小容量)
- 4.1.2 E110-X0I (大容量)

3.2 BGA SSD

- 4.2.1 US2200
- 4.2.2 US2230

4. Memory Module / メモリモジュール

4.1 DDR4 (EC販売予定)

- 5.1.1 XAP40A SODIMM (ノートPC用)
- 5.1.2 XAP40A UDIMM (デスクトップPC用)
- 5.1.3 XAS40A RDIMM (サーバー用)

4.2 DDR5

- 5.2.1 XAP50A SODIMM
- 5.2.2 XAP50A UDIMM
- 5.2.3 XAS50A RDIMM

5. Portable Storage / ポータブルストレージ

5.1 Micro SD Card / Trans Flash Card

- 6.1.1 T100
- 6.1.2 T150 (高速・大容量)

5.2 フラッシュドライブ (EC販売予定)

- 6.2.1 U2000
- 6.2.2 U3000 (多色)
- 6.2.3 U3500 (高速)

5.3 ポータブルSSD (EC販売予定)

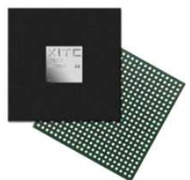
- 6.3.1 EM110 (暗号化)



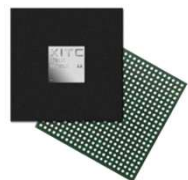
ストレージコントローラチップ
Storage Controller Chip

ストレージコントローラチップ

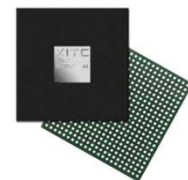
2.1 SATA Controller / SATAコントローラ



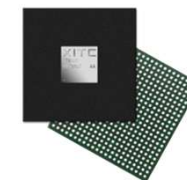
XT6110
SATA III、4CH x 8CE
最大4TBをサポート
商用セキュリティレベル1



XT6120
SATA III、8CH x 4CE
最大 8TB をサポート



XT6121
SATA III、2CH x 8CE
最大2TBをサポート
商用セキュリティレベル1



XT6160
SATA III、8CH x 4CE
最大16TBをサポート
商用セキュリティレベル2

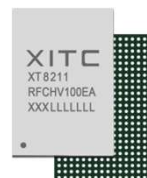
2.2 PCIe Controller / PCIeコントローラ



XT8111
PCIe 3.0 x4、4CH x 8CE
NVMe 1.3 転送プロトコル
最大8TBをサポート
商用セキュリティレベル1



XT8221
PCIe 4.0 x4、4CH x 4CE
NVMe 2.1 転送プロトコル
最大 8TB をサポート



XT8211
PCIe 4.0 x4、4CH x 8CE
NVMe 1.4 転送プロトコル
最大 8TB をサポート



XT8310
PCIe 5.0 x4、16CH x 8CE
NVMe 2.0 転送プロトコル
最大32TBをサポート

2.3 eMMC Controller / eMMCコントローラ



XT5521
eMMC 5.1、1CH x 4CE
最大128GBをサポート



ソリッドステートドライブ
Solid State Drive

DS1000

SATA III



2.5inch

mSATA

・ DS1000 シリーズ は、主に高信頼性、広温度範囲アプリケーションに使用される。

・ DS1000 シリーズSSD は、自社開発の XT6110 SATA SSD コントローラと高信頼性 gTLC をベースとして、信頼性と互換性の両方を実現している。

製品仕様/Specification

仕様	2.5inch			mSATA		
容量 (GB)	1,024	2,048	4,096	512	1,024	2,048
TBW(TB) @JESD218 Client Workload	≥1,440	≥2,880	≥5,760	≥720	≥1,440	≥2,880
性能	128KBシーケンシャル読取り (MB/秒) : 最大560			128KBシーケンシャル書込み (MB/秒) : 最大490		
	4K ランダム読取りIOPS : 最大 86,800			4K ランダム書込みIOPS : 最大83,600		
消費電力 (W)	≤1.1 (idle) ; ≤3.2 (active)			≤1 (idle) ; ≤2.8 (active)		
チップ	KIOXIA Bics5					
製品インターフェース	SATA III (6.0Gbps)					
動作温度	-40~85°C (作業状態)			-55~95 °C (ストレージ状態)		
平均故障間隔 (MTBF)	≥2,000,000 hours					
訂正不可能なエラー率 (UBER)	≤ 10 ¹⁶					
振動/衝撃	15G @ 10~2,000 Hz			1,000G @ 0.5 ms, 3軸		
特性	広い温度範囲 (-40°C~85°C)、直接書込みモード、ソフト消去機能、PLP停電保護					

応用シナリオ/Application scenario

鉄道輸送



産業用データ収集



PCの耐久性向上



特殊産業制御機器



産業グレードの機能：

全モデルはハードウェアレベルの停電保護機能に対応。
 全モデルはインテリジェントなデータ消去機能に対応。
 全モデルは耐硫化設計に対応。



▶製品仕様/Specification

仕様	2.5inch				mSATA		
	容量 (GB)	512	1,024	2,048	4,096	256	512
TBW(TB) @JESD218 Client Workload	≥400	≥800	≥1,600	≥3,200	≥200	≥400	
性能	128KBシーケンシャル読取り (MB/秒) : 最大560						
	128KBシーケンシャル書込み (MB/秒) : 最大460						
	4K ランダム読取りIOPS : 最大 83,000						
	4K ランダム書込みIOPS : 最大82,000						
消費電力 (W)	≤1.22 (idle) ; ≤4.36 (active)				≤0.61 ; ≤2.96		
チップ	YMTC 3D TLC						
製品インターフェース	SATA III (6.0Gbps)						
動作温度	0~70 °C (作業状態) -40~85 °C (ストレージ状態)						
平均故障間隔 (MTBF)	≥2,000,000 hours						
訂正不可能なエラー率 (UBER)	≤ 10 ¹⁶						
振動/衝撃	15G @ 10~2,000 Hz		1,000G @ 0.5 ms, 3 軸				
特性	直接書込みモード、PLP停電保護						

・ DS1200Proシリーズは、主に高信頼性、広範囲温度アプリケーションに使用される。

・ DS1200ProシリーズのSSD は、自社開発の XT6110 SATA SSDコントローラと高信頼性 gTLC をベースとして、信頼性と互換性の両方を実現している。

▶応用シナリオ/Application scenario

鉄道輸送



産業用データ収集



PCの耐久性向上



特殊産業制御機器



産業グレードの機能：

全モデルはハードウェアレベルの停電保護機能に対応

全モデルはインテリジェントなデータ消去機能に対応。ハードウェアレベルの暗号化アルゴリズムモジュールを内蔵し、アクセス制御、PBAプリブート、ディスク全体とパーティションの暗号化、隠しパーティション、その他のカスタマイズされたセキュリティ機能をサポート。

▶製品仕様/Specification

仕様	2.5inch	mSATA	M.2 2280	M.2 2242
容量 (GB)	128~1,024	64~1,024	128~1,024	64~512
TBW(TB) @JESD218 Client Workload	120~1,000	60~1,000	120~1,000	60~500
性能	128KBシーケンシャル読取り (MB/秒) : 最大560 128KBシーケンシャル書込み (MB/秒) : 最大440 4K ランダム読取りIOPS : 最大60,000 4K ランダム書込みIOPS : 最大62,000			
消費電力 (W)	≤0.6 (idle) ≤1.3 (active)	≤0.6 (idle) ≤1.2 (active)	≤0.6 (idle) ≤1.1 (active)	≤0.6 (idle) ≤1.1 (active)
チップ	YMTC 3D TLC			
製品インターフェース	SATA III (6.0Gbps)			
動作温度	0~70 °C (作業状態)		-40~85 °C (ストレージ状態)	
平均故障間隔 (MTBF)	≥2,000,000 hours			
訂正不可能なエラー率(UBER)	≤ 10 ¹⁶			
振動/衝撃	15G @ 10~2,000 Hz		1,000G @ 0.5 ms, 3 軸	
特性	セキュア消去機能、フルディスク SLC キャッシュ機能			

DS2200

標準温度
SATA III



・DS2200シリーズは、新しいダイレクトライトファームウェアとYMTC 3D TLCフラッシュメモリチップを搭載し、優れた耐久性を備え、-0°C~70°Cの標準温度範囲で安定動作する。2.5インチ、mSATA、2280、2242、4種類の仕様展開で、容量は64GB~1TBまでカバーしている。

・ハードウェアレベルの暗号化アルゴリズムモジュールを内蔵し、アクセス制御、PBA プリブート、ディスク全体とパーティションの暗号化、などのセキュリティ機能をサポートする。

▶応用シナリオ/Application scenario



▶製品仕様/Specification

仕様	2.5inch	mSATA	M.2 2280	M.2 2242
容量 (GB)	128~2,048	128~2,048	1,024	128~512
TBW(TB) @JESD218 Client Workload	120~2,000	120~2,000	1,000	120~500
性能				
	128KBシーケンシャル読取り (MB/秒) : 最大560			
	128KBシーケンシャル書込み (MB/秒) : 最大410			
	4K ランダム読取りIOPS : 最大41,000			
	4K ランダム書込みIOPS : 最大51,000			
消費電力 (W)	≤0.6 (idle) ; ≤1.5 (active)			
チップ	YMTC 3D TLC			
製品インターフェース	SATA III (6.0Gbps)			
動作温度	-40~85 °C (作業状態) -55~95° C (ストレージ状態)			
平均故障間隔 (MTBF)	≥2,000,000 hours			
訂正不可能なエラー率(UBER)	≤ 10 ¹⁶			
振動/衝撃	20G @ 10~2,000 Hz 1,000G @ 0.5 ms, 3 axis			
特性	硫化防止、データ破壊防止、PLP停電保護			

DS2200

広範囲温度
SATA III



・DS2200シリーズは、新しいダイレクトライトファームウェアとYMTC 3D TLCフラッシュメモリチップを搭載し、優れた耐久性を備え、-40°C~85°Cの温度範囲で安定動作する。2.5インチ、mSATA、2280、2242、4種類の仕様展開で、容量は128GB~2TBまでカバーしている。

・ハードウェアレベルの暗号化アルゴリズムモジュール内蔵し、アクセス制御、PBA プリブート、ディスク全体とパーティションの暗号化、などのセキュリティ機能をサポートする。

▶応用シナリオ/Application scenario

サイバーセキュリティ



電力



金融



エネルギー



産業用制御



産業グレードの機能：

全モデルはハードウェアレベルの停電保護機能に対応。
全モデルはインテリジェントなデータ消去機能に対応。
全モデルは硫化防止に対応。



▶製品仕様/Specification

仕様	2.5inch	mSATA	M.2 2242
容量 (GB)	128	8~64	8~32
TBW(TB) @JESD218 Client Workload	2,560	380~1,280	380~800
性能			
	128KBシーケンシャル読取り (MB/秒) : 最大560		
	128KBシーケンシャル書込み (MB/秒) : 最大400		
	4K ランダム読取りIOPS : 最大49,000		
	4K ランダム書込みIOPS : 最大61,000		
消費電力 (W)	≤0.6 (idle)	≤1.5 (active)	
チップ	YMTC 3D TLC(pSLC応用)		
製品インターフェース	SATA III (6.0Gbps)		
動作温度	40~85°C (作業状態)	-55~95 °C (ストレージ状態)	
平均故障間隔 (MTBF)	≥2,000,000 hours		
訂正不可能なエラー率(UBER)	≤ 10 ¹⁶		
振動/衝撃	20G @ 10~2,000 Hz	1,000G @ 0.5 ms, 3 軸	
特性	硫化防止、高寿命		

・ DS2130シリーズは、新しいダイレクトライトファームウェア、YMTC 3D TLCフラッシュメモリチップ、Xtrans-SLCアプリケーションテクノロジーを採用している。

・ 優れた耐久性を備え、-40°C~85°Cの温度範囲で安定動作する。2.5インチ、mSATA、2242、3種類の仕様展開で、容量は8GB~128GBまでカバーしている。

▶応用シナリオ/Application scenario

5G基地局



プログラム制御
交換機



ファイアウォール



ゲートウェイ
ルーティング



DS2140

SATA III



・DS2140シリーズは、新しいダイレクトライトファームウェアとYMTC 3D TLCフラッシュメモリチップを搭載し、優れた耐久性を備え、-40°C~85°Cの温度範囲で安定動作する。

・2.5インチ、mSATA、2280、2242、4種類の仕様展開で、容量は8GB~1TBまでカバーしている。

製品仕様/Specification

仕様	2.5inch	mSATA	M.2 2280	M.2 2242
容量 (GB)	1,024	8~1,024	256~1,024	32~128
TBW(TB) @JESD218 Client Workload	1,000	65~1,000	375~1,000	75~185
性能	128KBシーケンシャル読取り (MB/秒) : 最大510			
	128KBシーケンシャル込み (MB/秒) : 最大300			
	4K ランダム読取りIOPS : 最大42,000			
	4K ランダム書込みIOPS : 最大45,000			
消費電力 (W)	≤0.7 (idle) ; ≤1.9 (active)			
チップ	YMTC 3D TLC(pMLC应用)			
製品インターフェース	SATA III (6.0Gbps)			
動作温度	-40~85° C (作業状態)		-55~95° C (ストレージ状態)	
平均故障間隔 (MTBF)	≥2,000,000 hours			
訂正不可能なエラー率(UBER)	≤ 10 ¹⁶			
振動/衝撃	20G @ 10~2,000 Hz		1,000G @ 0.5 ms, 3 軸	
特性	インテリジェントなデータ消去、硫化防止、PLP 停電保護			

応用シナリオ/Application scenario

サイバーセキュリティ



電力



PCの耐久性向上



産業用制御



SS2000SE

SATA III



2.5inch

・SS2000SEシリーズのエンタープライズグレード SATA SSDは、独自に開発されたXT6120ENコントローラーとファームウェアをベースとし、YMTCの新一代3D TLC NANDフラッシュを搭載し、データセンターやエンタープライズのお客様に業界をリードする高性能、低レイテンシ、高信頼性、長寿命のSSDを提供する。

・エンタープライズサーバーおよびストレージアレイのシステムディスクおよびデータディスクとして使用される。

製品仕様/Specification

仕様	2.5inch			
容量 (GB)	480	960	1,920	3,840
TBW(TB) @JESD219 Enterprise Workload	≥876	≥1,752	≥3,504	≥7,008
性能	128KBシーケンシャル読取り：最大560 (MB/秒) 128KBシーケンシャル書込み：最大520 (MB/秒) 4K ランダム読取り (定常状態) IOPS：最大98,000 4K ランダム書込み (定常状態) IOPS：最大 45,000			
消費電力 (W)	≤1.6 (idle)		≤4.0 (active)	
チップ	YMTC 3D TLC			
製品インターフェース	SATA III (6.0Gbps)			
動作温度	0~70 °C (作業状態)		-40~85 °C (ストレージ状態)	
平均故障間隔 (MTBF)	≥2,000,000 hours			
訂正不可能なエラー率 (UBER)	≤ 10 ¹⁷			
耐久性	1 DWPD (5年間、データ書込み量がTBWを超えない)			
振動/衝撃	3.13G @ 5~800 Hz		1,000G @ 0.5 ms, 3 軸	
特性	強化PLP、E2E、RAID+、ECC、4K LDPC、高温保護、TRIM、オンラインアップグレード、SMART			

応用シナリオ/Application scenario

IT革新



インターネット



公共機関



ファイナンス



包括的なデータ信頼性保証：

NANDXtraデータ信頼性エンジンは、インテリジェントなウェアレベリング技術により、データ書込みを全体的に最適化し、フラッシュメモリの寿命と信頼性を効果的に向上させる。

ECC、LDPC、リードリトライなどの技術により、データエラー訂正機能を大幅に強化する。RAID、データ検査、高温保護、不良ブロック管理技術を採用し、ディスクとデータの安全性と信頼性を総合的に確保する。

▶製品仕様/Specification

SS6000SE

SATA III



2.5inch

M.2 2280

・SS6000SEシリーズSATA SSDは、Xtacking 4.0 3D TLCフラッシュメモリチップを採用し、独自のファームウェアアルゴリズムとIntelligent Block Management Technologyを組み合わせ、フラッシュメモリの読み書きメカニズムを徹底的に最適化することで、製品のパフォーマンス、信頼性、コスト効率が大幅に向上している。

・容量は240GBから7.68TBまで幅広く取り揃え、エンタープライズグレードのSATA SSDソリューションをワンストップで提供する。

▶応用シナリオ/Application scenario

IT革新



インターネット



公共機関



ファイナンス



仕様	2.5inch					M.2 2280-B-M		
	480	960	1,920	3,840	7,680	240	480	960
容量 (GB)	480	960	1,920	3,840	7,680	240	480	960
TBW(TB) @JESD219 Enterprise Workload	≥876	≥1,752	≥3,504	≥7,008	≥14,016	≥438	≥876	≥1,752
性能	128KBシーケンシャル読取り (MB/秒) : 最大560							
	128KBシーケンシャル書込み (MB/秒) : 最大520							
	4K ランダム読取りIOPS : 最大98,000							
4K ランダム書込みIOPS	最大 45,000					最大30,000		
消費電力 (W)	≤1.2 (idle) ; ≤4.0 (active)					≤1.1 (idle) ; ≤3.0 (active)		
チップ	YMTC 3D TLC							
製品インターフェース	SATA III (6.0Gbps)							
動作温度	0~70 °C (作業状態)				-40~85 °C (ストレージ状態)			
平均故障間隔 (MTBF)	≥2,500,000 hours							
訂正不可能なエラー率 (UBER)	≤ 10 ¹⁷							
耐久性	1 DWPD (5年間、データ書込み量がTBWを超えない)							
振動/衝撃	3.13G @ 5~800 Hz 1,000G @ 0.5 ms, 3 軸					20G @ 20~2,000 Hz 1,500G @ 0.5 ms, 3 軸		
特性	4K LDPC、RAID、SRAM ECC、DRAM ECC、E2EDP、TRIM、SMART、高温保護、停電保護、オンライン アップグレード、セキュア ブート、TCG							

包括的なデータ信頼性保証：

NANDXtraデータ信頼性エンジンは、インテリジェントなウェアレベリング技術により、データ書き込みを全体的に最適化し、フラッシュメモリの寿命と信頼性を効果的に向上。ECC、LDPC、リードリトライなどの技術により、データエラー訂正機能を大幅に強化する。

RAID、データ検査、高温保護、不良ブロック管理技術を採用し、ディスクとデータの安全性と信頼性を総合的に確保。

DP2100

PCIe 3.0



M.2 2242 M.2 2280

・ DP2100 SSDは、PCIe 3.0コントローラチップを搭載し、3D TLC NANDを採用し、高速PCIe 3.0x4インターフェースを備え、NVMe 1.4プロトコルをサポートする。

・ 産業用PC、産業オートメーション、産業用ブラックボックス、産業用IPC、光ファイバー端末、ミニPC、開発ボード、プロセス制御ユニット、データロガーなど、幅広い用途で使用され、包括的な産業グレードSSDソリューションを提供する。

製品仕様/Specification

仕様	M.2 2242			
容量 (GB)	256	512	1,024	2,048
TBW(TB) @JESD219 Client Workload	≥120	≥240	≥480	≥960
性能				
	128KBシーケンシャル読取り：最大3,500 (MB/秒)			
	128KBシーケンシャル書込み：最大3,400 (MB/秒)			
	4K ランダム読取り (定常状態) IOPS：最大520,000			
	4K ランダム書込み (定常状態) IOPS：最大590,000			
消費電力 (W)	≤4m (idle) ; ≤1.6 (active)			
チップ	3D TLC			
製品インターフェース	PCIe Gen 3 x 4			
動作温度	0~70 °C (作業状態) -40~85 °C (ストレージ状態)			
平均故障間隔 (MTBF)	≥1,500,000 hours			
訂正不可能なエラー率 (UBER)	≤ 10 ¹⁶			
耐久性	1 DWPD (5年間、データ書込み量がTBWを超えない)			
振動/衝撃	20G @ 20~2000 Hz 1,000G @ 0.5 ms, 3 軸			
特性	ATA セキュリティ暗号化、セキュア消去、ECCエラー訂正、Host Led機能、PLN 機能			

応用シナリオ/Application scenario

ミニPC

産業用ブラックボックス

開発ボード

産業用IPC

サーバーボード

産業用制御



信頼性・安定性・効率性：

RAID機能により信頼性が122倍向上。
SRAM ECC機能によりデータの整合性を確保。
3D TLC NANDと自社開発の智能ブロック管理技術により、製品寿命が延長され、極端な温度にも適応。
DRAMレス設計により電力損失のリスクを軽減し、PLN/PLA機能をサポートし、キャッシュ保護効率が5倍向上。

DP2100HE

PCIe 3.0



・ DP2100HE SSDは、PCIe 3.0コントローラチップを搭載し、3D TLC NANDを採用し、高速PCIe 3.0 x4インターフェースを備え、NVMe 1.4プロトコルをサポートする。

・ 産業用PC、産業オートメーション、産業用ブラックボックス、産業用IPC、光ファイバー端末、ミニPC、開発ボード、プロセス制御ユニット、データロガーなど、幅広い用途で使用され、包括的な産業グレードSSDソリューションを提供する。

製品仕様/Specification

仕様	M.2 2242							
	dTLC				pSLC			
容量 (GB)								
容量 (GB)	32	64	128	240	16	32	64	128
TBW(TB) @JESD219 Client Workload	41	82	165	308	1400	1050	2125	4250
性能								
	128KBシーケンシャル読取り (MB/秒) : 最大3,300							
	128KBシーケンシャル書込み (MB/秒) : 最大2,400							
	4K ランダム読取りIOPS : 最大450,000							
	4K ランダム書込みIOPS : 最大400,000							
消費電力 (W)	≤0.4 (idle) ; ≤1.1 (active)							
チップ	3D TLC							
製品インターフェース	PCIe Gen 3 x 4							
動作温度	0~70 °C (作業状態)				-40~85 °C (ストレージ状態)			
平均故障間隔 (MTBF)	≥2,000,000 hours							
訂正不可能なエラー率(UBER)	≤ 10 ¹⁶							
耐久性	> 0.8 DWPD (5年間、データ書込み量がTBWを超えない)							
振動/衝撃	20G @ 10~2000 Hz 1,000G @ 0.5 ms, 3 軸							
特性	ATA セキュリティ暗号化、セキュア消去、ECCエラー訂正、Host Led機能、PLN 機能							

応用シナリオ/Application scenario

ミニPC

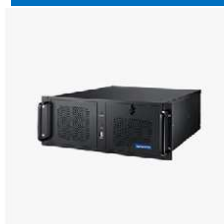
産業用ブラックボックス

開発ボード

産業用IPC

サーバーボード

産業用制御



信頼性/安定性/効率性 :

RAID機能により信頼性が122倍向上。
SRAM ECC機能によりデータの整合性を確保。
3D TLC NANDと自社開発の知能ブロック管理技術により、製品寿命が延長され、極端な温度にも適応。
DRAMレス設計により電力損失のリスクを軽減し、PLN/PLA機能をサポートし、キャッシュ保護効率が5倍向上。

SP5000

PCIe 5.0



U.2 15mm

・ SP5000シリーズエンタープライズクラス PCIe SSDは、XT8310コントローラを搭載した高性能ストレージソリューション。2.5インチU.2フォームファクタとPCIe Gen5 x4インターフェースを採用し、1.6TBから15.36TBまでの容量を誇り、1DWPDと3DWPDの書き込みエンドをサポート。

・ 産業用PC、産業オートメーション、産業用ブラックボックス、産業用IPC、光ファイバー端末、ミニPC、開発ボード、プロセス制御ユニット、データロガーなど、幅広い用途で使用され、包括的な産業グレードSSDソリューションを提供する。

製品仕様/Specification

仕様	U.2 15mm					
容量 (TB)	1.6	1.92	3.2	3.84	6.4	7.68
TBW(TB) @JESD219 Enterprise Workload	8,760	3,504	17,520	7,008	35,040	14,016
性能	128KBシーケンシャル読取り (MB/秒: 最大 14,000) 128KBシーケンシャル書込み (MB/秒: 最大 8,500) 4K ランダム読取りIOPS: 最大 3,000,000 4K ランダム書込みIOPS: 最大 900,000					
消費電力 (W)	≤9 (idle) ; ≤25 (active)					
チップ	3D TLC					
製品インターフェース	PCIe Gen5.0					
動作温度	0~70 °C (作業状態) -40~85 °C (ストレージ状態)					
平均故障間隔 (MTBF)	≥2,500,000 hours					
訂正不可能なエラー率 (UBER)	≤ 10 ¹⁸					
耐久性	1 DWPD(1.92TB, 3.84TB, 7.68TB) or 3 DWPD(1.6TB, 3.2TB, 6.4TB) (両方とも5年間、データ書込み量がTBWを超えない)					
振動/衝撃	16.3G @ 10~2000 Hz 1,000G @ 0.5 ms					
特性	S.M.A.R.T. 機能、TRIMコマンド、PLP停電保護、E2Eデータ保護、AES-XTS 256ハードウェア暗号化、SRAM ECC、高温保護、ディスク内RAID、オンラインアップグレード、ホットスワップ					

応用シナリオ/Application scenario

<p>データセンター</p> 	<p>インターネット</p> 	<p>公共機関</p> 	<p>ファイナンス</p> 	<p>オペレーター</p> 
--	--	---	--	---

デュアルポート設計
データの信頼性
高保守性

EP2000Pro

PCIe 3.0



▶製品仕様/Specification

仕様	M.2 2280			
容量 (GB)	256	512	1,024	2,048
TBW(TB) @JESD219 Client Workload	100	200	400	800
性能				
	128KBシーケンシャル読取り (MB/秒) : 最大3,500			
	128KBシーケンシャル書込み (MB/秒) : 最大3,400			
	4K ランダム読取りIOPS : 最大520,000			
	4K ランダム書込みIOPS : 最大590,000			
消費電力 (W)	≤0.1 (idle) ; ≤3.7 (active)			
チップ	3D TLC			
製品インターフェース	PCIe Gen 3 x 4			
動作温度	0~70 °C (作業状態) -40~85 °C (ストレージ状態)			
平均故障間隔 (MTBF)	≥1,500,000 hours			
訂正不可能なエラー率 (UBER)	≤ 10 ¹⁶			
耐久性	1 DWPD (3年間、データ書込み量がTBWを超えない)			
振動/衝撃	20G @ 20~2000 Hz 1,500G @ 0.5 ms, 3軸			
特性	ATA セキュリティ暗号化、セキュア消去、ECCエラー訂正、Host Led機能			

・ EP2000 Proは、PCIe 3.0コントローラチップを搭載し、3D TLC NANDを採用し、高速PCIe 3.0 x 4インターフェースを備え、NVMe 1.4プロトコルをサポートし、NANDXtra®およびNANDSafe™テクノロジーを搭載し、耐久性と信頼性を大幅に向上。

・ 高速フラッシュI/OとダイナミックSLCキャッシュテクノロジーを搭載し、PCIe 3.0搭載の同等製品と比較して、オフィス文書の起動速度が15~25%向上し、ブラウザ、ソーシャルネットワーキングなどのAPPの起動速度も5~20%向上する。

▶応用シナリオ/Application scenario

ノートPC

ワークステーション

オールインワンPC

OPS

デスクトップ



高性能/高効率
高い互換性、高寿命

EP3000

PCIe 4.0



M.2 2280

・ EP3000は、PCIe 4.0コントローラチップを搭載し、3D TLC NANDを採用し、高速PCIe 4.0 x 4インターフェースを備え、NVMe 1.4プロトコルをサポートし、NANDXtra[®]およびNANDSafe[™]テクノロジーを搭載し、耐久性と信頼性を大幅に向上。

・ 高速フラッシュI/OとダイナミックSLCキャッシュテクノロジーを搭載することによって、大規模データの高速読取り/書込みを満たし、データフローの効率と安定性を確保し、ユーザーにこれまでにない高速ストレージエクスペリエンスを提供。

▶ 応用シナリオ/Application scenario

ノートPC



ワークステーション



オールインワンPC



OPS



デスクトップ



▶ 製品仕様/Specification

仕様	M.2 2280			
容量 (GB)	256	512	1,024	2,048
TBW(TB) @JESD219 Client Workload	100	200	400	800
性能				
	128KBシーケンシャル読取り (MB/秒) : 最大5,000			
	128KBシーケンシャル書込み (MB/秒) : 最大5,000			
	4K ランダム読取りIOPS : 最大600,000			
	4K ランダム書込みIOPS : 最大600,000			
消費電力 (W)	≤0.5 (idle) ; ≤7 (active)			
チップ	3D TLC/QLC			
製品インターフェース	PCIe Gen 4x4			
動作温度	0~70 °C (作業状態)		-40~85 °C (ストレージ状態)	
平均故障間隔 (MTBF)	≥1,500,000 hours			
訂正不可能なエラー率 (UBER)	≤ 10 ¹⁶			
耐久性	1 DWPD (3年間、データ書込み量がTBWを超えない)			
振動/衝撃	20G @ 20~2000 Hz		1,500G @ 0.5 ms, 3 axis	
特性	ATA セキュリティ暗号化、セキュア消去、ECCエラー訂正、Host Led機能			

高性能/高効率
 高い互換性、高寿命



組み込みストレージ
Embedded Storage

▶製品仕様/Specification

仕様	BGA153			
容量 (GB)	4	8	16	32
性能				
128KBシーケンシャル読み取り (MB/秒)	最大300			
128KBシーケンシャル書き込み (MB/秒)	最大130	最大130	最大210	最大240
4K ランダム読み取りIOPS	最大4,500			
4K ランダム書き込みIOPS	最大2,000			
消費電力(mA)				
active write	80 (ICC);90 (ICCQ)	80 (ICC);95 (ICCQ)	120 (ICC);95 (ICCQ)	130 (ICC);95 (ICCQ)
active read	110 (ICC);150 (ICCQ)	110 (ICC);150 (ICCQ)	110 (ICC);150 (ICCQ)	120 (ICC);150 (ICCQ)
standby	50 (ICC);95 (ICCQ)	50 (ICC);100 (ICCQ)	70 (ICC);150 (ICCQ)	120 (ICC);110 (ICCQ)
sleep	40 (ICC);70 (ICCQ)	50 (ICC);70 (ICCQ)	60 (ICC);70 (ICCQ)	110 (ICC);80 (ICCQ)
P/E Cycles	40,000			
電圧	Memory Power (VCC) : 3.3 V ; Interface Power (VCCQ) : 1.8 V or 3.3 V			
チップ	YMTC pSLC			
製品インターフェース	eMMC 5.1			
動作温度	-40~85 °C (作業状態) -40~85 °C (ストレージ状態)			
特性	LDPC、ウェアレベリング、巡回点検管理、停電保護、システムデータ保護			

E110-X01 小容量

eMMC 5.1



BGA153

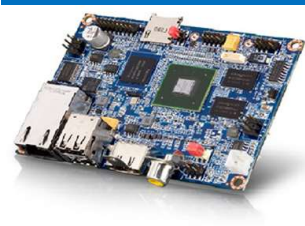
・ E110-X01シリーズの小容量製品は、高い信頼性と長寿命が求められる組み込み分野の産業用アプリケーションを主なターゲットとしている。

・ 製品自体は、優れた耐衝撃性、低消費電力、小型サイズ、ピン間の互換性など、eMMC 製品の利点を備えている。

・ 消去/書き込みサイクル寿命は最大40,000 サイクル (pSLC) で、10 年以上の使用に耐える。

▶応用シナリオ/Application scenario

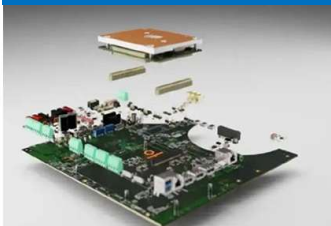
産業用ボード



産業用組み込みシステム



COM-E



産業用電力機器



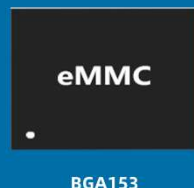
高信頼性 / 高寿命 / 低消費電力

▶製品仕様/Specification

仕様	BGA153	
容量 (GB)	64	128
性能		
128KBシーケンシャル読み取り	最大295 (MB/秒)	
128KBシーケンシャル書き込み	最大210 (MB/秒)	
4K ランダム読み取りIOPS	最大 4,500	
4K ランダム書き込みIOPS	最大 1,750	
消費電力 (mA)		
active write	95 (ICC) ;85 (ICCQ)	100 (ICC) ;85 (ICCQ)
active read	105 (ICC) ;130 (ICCQ)	
standby	70 (ICC) ;105 (ICCQ)	
sleep	75 (ICC) ;100 (ICCQ)	
P/E Cycles	30,000	
電圧	Memory Power (VCC) : 3.3 V ; Interface Power (VCCQ) : 1.8 V or 3.3 V	
チップ	YMTC TLC	
製品インターフェース	eMMC 5.1	
動作温度	-40~75 °C (作業状態) -40~85 °C (ストレージ状態)	
特性	LDPC、ウェアレベリング、巡回点検管理、停電保護、システムデータ保護	

E110-X0I 大容量

eMMC 5.1



・ E110-X0Iシリーズの大容量製品は、主に大容量が求められる一般産業用アプリケーション市場をターゲットにしている。

・ 製品自体は、優れた耐衝撃性、低消費電力、小型サイズ、ピン間の互換性など、eMMC 製品の利点を備えている。

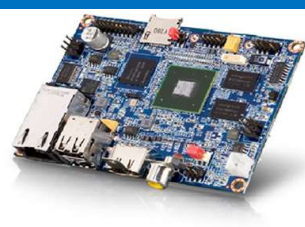
・ 準広温度範囲を満たす条件下では、製品容量は最大128GBまでサポートできる。

▶応用シナリオ/Application scenario

産業用カメラ



広範囲温度ボード



COM-E



産業用メディア
機器



高信頼性 / 大容量 / 低消費電力



▶製品仕様/Specification

仕様	BGA156				
容量 (GB)	60	128	256	512	1,024
性能					
128KBシーケンシャル読み取り (MB/秒)	最大235	最大 440	最大540	最大 500	最大 500
128KBシーケンシャル書き込み (MB/秒)	最大60	最大120	最大 220	最大390	最大410
4K ランダム読み取りIOPS	最大13,000	最大26,000	最大42,000	最大42,000	最大42,000
4K ランダム書き込みIOPS	最大14,000	最大26,000	最大40,000	最大48,000	最大55,000
消費電力 (W)	≤0.5 (idle) ; ≤1.5 (active)				
P/E Cycles	3,000				
電圧	VCC : 2.5 V VCCQ : 1.2 V VDD/VDDA : 1.1 V ; VDDIO/VDDHA : 3.3 V				
チップ	YMTC iTLC				
製品インターフェース	SATA3.1				
動作温度	-40~85 °C (作業状態) -40~95 °C (ストレージ状態)				
特性	セキュア消去、オンラインアップグレード、高温による速度制限、システム領域/データ領域巡回検査、RAID、SRAM ECC、ウェアレベリング、不良ブロック管理				

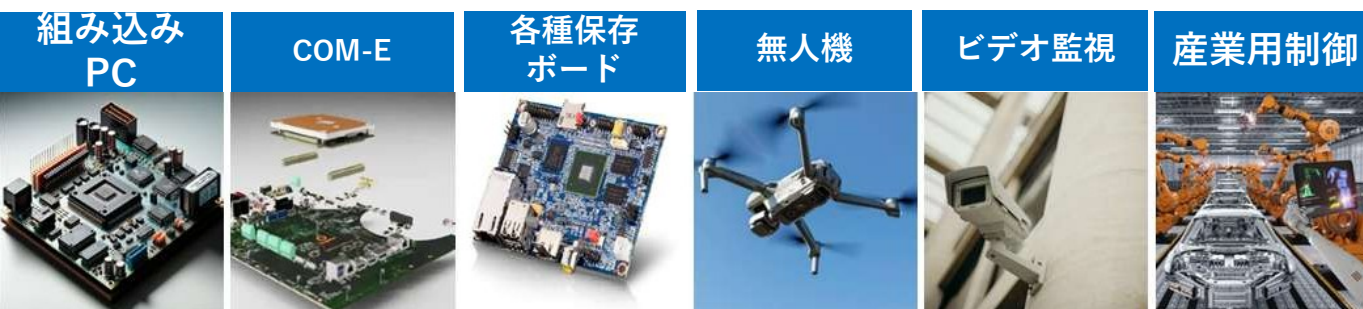
・US2200製品シリーズは、主に組み込み分野の大容量市場をターゲットと、耐振動性、低消費電力、小型、大容量などの利点が備わっている。

・独立した電源供給方式を採用し、動作中の消費電力を抑え、バッテリー駆動の製品をより長時間動作させることができる。

・TLC モード製品は最大 1TB の容量を提供し、産業用組み込み製品では限られたスペースでも高密度ストレージソリューションを実現できる。

高信頼性 / 大容量 / 低消費電力

▶応用シナリオ/Application scenario



US2230

SATA III



・ US2230製品シリーズは、主に高い信頼性と長寿命が求められる組み込みシステム市場を主にターゲットにしている。耐振動性、低消費電力、小型、大容量などの利点が備わっている。

・ 独立した電源供給方式を採用し、動作中の消費電力を抑え、バッテリー駆動の製品をより長時間動作させることができる。

・ 書き込み/消去サイクル寿命が最大 60,000 サイクル (pSLC) であり、10 年以上の使用に耐えるように設計されている。

製品仕様/Specification

仕様	BGA156		
容量 (GB)	32	64	128
性能			
128KBシーケンシャル読み取り (MB/秒)	最大535	最大560	最大560
128KBシーケンシャル書き込み (MB/秒)	最大385	最大400	最大410
4K ランダム読み取りIOPS	最大40,000	最大56,500	最大58,000
4K ランダム書き込みIOPS	最大58,000	最大59,000	最大60,000
消費電力 (W)	≤0.5 (idle) ; ≤1.1 (active)		
P/E Cycles	60,000		
電圧	VCC : 2.5 V VCCQ : 1.2 V VDD/VDDA : 1.1 V ; VDDIO/VDDHA : 3.3 V		
チップ	YMTC iTLC@pSLC		
製品インターフェース	SATA3.1		
動作温度	-55~85 °C (作業状態) -55~95 °C (ストレージ状態)		
特性	セキュア消去、オンラインアップグレード、高温による速度制限、システム領域/データ領域巡回検査、RAID、SRAM ECC、ウェアレベリング、不良ブロック管理		

応用シナリオ/Application scenario

高仕様保存
ボード



COM-E



FPGA



産業用制御



車載



高信頼性 / 長寿命 / 低消費電力



メモリモジュール
Memory Module

XAP40A

SODIMM



- ・ DDR4-3200 ノートPC用メモリ 8GB/16GB
- ・ JHICC/Samsung/Hynix DDR4 チップを採用
- ・ 3200MT/sをサポートし、ノートPCのプロセッサ性能要件を満たす
- ・ 初期不良品の無料交換を保証

▶製品仕様/Specification

テクノロジーの世代	DDR4	
容量(GB)	8	16
クロック速度	1600 MHz	
データ転送速度	3200 MT/s	
バス幅	x64	
帯域幅	PC4-25600	
CL値	22-22-22	
ECC	NO	
チップ仕様	JHICC 1Gb x8 Samsung 1Gb x8 Hynix 1Gb x8	
チップ数	8	16
動作電圧	1.2V	
動作温度	0°C ~ 85°C	
外形寸法(mm)	69.6x 30	

▶応用シナリオ/Application scenario

ノートPC



ミニPC



組み込み器機



産業用制御端末



ネットワーク
機器



XAP40A

UDIMM



- ・DDR4-3200 デスクトップPC用メモリ 8GB/16GB
- ・JHICC/Samsung/Hynix DDR4 チップを採用
- ・3200MT/sをサポートし、デスクトップPCのプロセッサ性能要件を満たす
- ・初期不良品の無料交換を保証

▶製品仕様/Specification

テクノロジーの世代	DDR4	
容量(GB)	8	16
クロック速度	1600 MHz	
データ転送速度	3200 MT/s	
バス幅	x64	
帯域幅	PC4-25600	
CL値	22-22-22	
ECC	NO	
チップ仕様	JHICC 1Gb x8 Samsung 1Gb x8 Hynix 1Gb x8	
チップ数	8	16
動作電圧	1.2V	
動作温度	0°C ~ 85°C	
外形寸法(mm)	133.35x 30.75	

▶応用シナリオ/Application scenario

ワークステーション



デスクトップ



組み込み機器



産業用制御端末



ネットワーク機器



XAS40A

RDIMM



- ・ DDR4-3200 サーバー用メモリ 16GB/ 32GB
- ・ Samsung/Hynix DDR4 チップを採用
- ・ 最高3200MT/sをサポートし、サーバーのプロセッサ性能要件を満たす
- ・ 初期不良品の無料交換を保証

▶製品仕様/Specification

テクノロジーの世代	DDR4	
容量(GB)	16	32
クロック速度	1600 MHz/1466 MHz	
データ転送速度	3200 MT/s/2933 MT/s	
バス幅	x72	
帯域幅	PC4-25600	
CL値	22-22-22	
ECC	YES	
チップ仕様	Samsung 2G×4/JHICC 2G x4	
チップ数	18	36
動作電圧	1.2V	
動作温度	0°C ~ 85°C	
外形寸法(mm)	133.35x 30.75	

▶応用シナリオ/Application scenario

ワークステーション



デスクトップ



組み込み機器



産業用制御端末



ネットワーク機器



XAP50A

SODIMM



- DDR5-5600 ノートPC用メモリ16GB/32GB
- Samsung DDR5 チップを採用
- 5600 MT/sをサポートし、ノートPCのプロセッサ性能要件を満たす
- 初期不良品の無料交換を保証

▶製品仕様/Specification

テクノロジーの世代	DDR5	
容量(GB)	16	32
クロック速度	2800 MHz	
データ転送速度	5600 MT/s	
バス幅	x64	
帯域幅	PC5-44800	
CL値	46-46-46-90	
ECC	NO	
チップ仕様	Samsung 1G x8	Samsung 2G x8
チップ数	8	16
動作電圧	1.1V	
動作温度	0°C ~ 85°C	
外形寸法(mm)	69.6x 30	

▶応用シナリオ/Application scenario

ノートPC



ミニPC



組み込み機器



産業用制御端末



ネットワーク
機器



XAP50A

UDIMM



- DDR5-5600 デスクトップPC用メモリ 16GB/32GB
- Samsung DDR5 チップを採用
- 5600MT/sをサポートし、デスクトップPCのプロセッサ性能要件を満たす
- 初期不良品の無料交換を保証

▶製品仕様/Specification

テクノロジーの世代	DDR5	
容量(GB)	16	32
クロック速度	2800 MHz	
データ転送速度	5600 MT/s	
バス幅	x64	
帯域幅	PC5-44800	
CL値	46-46-46-90	
ECC	NO	
チップ仕様	Samsung 1G x8	Samsung 2G x8
チップ数	8	16
動作電圧	1.1V	
動作温度	0°C ~ 85°C	
外形寸法(mm)	133.35x 30.75	

▶応用シナリオ/Application scenario

ワークステーション



デスクトップ



組み込み機器



産業用制御端末



ネットワーク機器



XAS50A

RDIMM



- DDR5-5600サーバープラットフォーム用メモリ 32GB/64GB
- SamsungなどのDDR5のチップを採用
- 最高5600MT/sをサポートし、サーバーのプロセッサ性能要件を満たす
- 初期不良品の無料交換を保証

▶製品仕様/Specification

テクノロジーの世代	DDR5	
容量(GB)	32	64
クロック速度	2800 MHz	
データ転送速度	5600 MT/s	
バス幅	x80	
帯域幅	PC5-44800	
CL値	46-46-46-90	
ECC	YES	
チップ仕様	Samsung 2Gx8 CXMT 2Gx8 Hynix 2Gx8	Hynix 4Gx4 CXMT 4Gx4
チップ数	20	20
動作電圧	1.1V	
動作温度	0°C ~ 85°C	
外形寸法(mm)	133.35x 30.75	

▶応用シナリオ/Application scenario

仮想化サーバー



クラウドサーバー



機械学習



データベース





ポータブルストレージ
Portable Storage

▶製品仕様/Specification

製品の的外観	microSDXC				
製品寸法	11mm x 15mm x 1mm				
互換性	microSDHC および microSDXC をサポートするホストデバイスと互換性がある				
スピードレベル	UHS-I, U3, V30, Class10				
容量(GB)	8	16	32	64	128
性能					
H2Test読み取り速度 (MB/秒)	60	60	65	75	70
H2Test書き込み速度 (MB/秒)	40	40	40	40	50
CDM読み取り速度 (MB/秒)	80	80	85	90	90
CDM書き込み速度 (MB/秒)	50	50	50	50	60
動作温度	0°C~70°C (動作時) ; -20°C~85°C (非動作時)				
動作湿度	8%~95% RH (結露なし)				
落下耐性	IEC 60068-2-31規格に準拠した1.5メートル自由落下テストに合格				
耐久性	IEC 60512-100規格に準拠した10,000回の抜き差しテストに合格				
その他	カード検出モードをサポートし、エラー訂正機能を備えている				

T100



Micro SD Card / Trans Flash Card

- ・ T100シリーズの高速Micro SDカード/Trans Flashカードは、高品質で高速なフラッシュメモリ技術を採用し、データの安定性と耐久性を確保している。
- ・ 8GBから128GBまでの容量構成を提供し、防水、防磁、耐衝撃性を備え、複雑な屋外環境にも適しており、日常的なストレージやコンテンツ作成に最適な信頼できる選択肢である。
- ・ 初期不良品の無料交換を保証

▶応用シナリオ/Application scenario

携帯電話



タブレット



無人機



レコーダー



デジカメ



柔軟な容量オプション / 高速データ転送 / 高互換性 / 多様なアプリケーションシナリオ
 ・ 高解像度の写真、1080pの動画録画、高速ファイル転送をサポートし、ドライブレコーダー、アクションカメラ、ドローン、PC、タブレットなどのデバイスに最適である。

▶製品仕様/Specification

製品の外観	microSDXC		
製品寸法	11mm x 15mm x1mm		
互換性	microSDHC および microSDXC をサポートするホストデバイスと互換性がある		
スピードレベル	UHS-I, U3, V30, Class10		
容量(GB)	256	512	1024
性能			
H2Test読み取り速度 (MB/秒)	70		
H2Test書き込み速度 (MB/秒)	50		
CDM読み取り速度 (MB/秒)	90		
CDM書き込み速度 (MB/秒)	65	75	75
動作温度	0°C~70°C (動作時) ; -20°C~85°C (非動作時)		
動作湿度	8%~95% RH (結露のない状態)		
落下耐性	IEC 60068-2-31規格の1.5メートルからの自由落下テストに合格		
耐久性	IEC 60512-100規格の10,000回の抜き差しテストに合格		
その他	カード検出モードをサポート、エラー訂正機能を備えている		

T150



高速・大容量

Micro SD Card / Trans Flash Card

- ・ T150シリーズは、高速・大容量のMicro SDカード/TransFlashカードで、写真、動画、ファイルを自由に保存できる。
- ・ 大容量と高い耐久性を兼ね備え、256GBから1TBまでの容量に対応している。
- ・ 安定した製品性能と優れたユーザーエクスペリエンスを保証するために、厳格なテストを受けている。
- ・ 初期不良品の無料交換を保証

▶応用シナリオ/Application scenario

携帯電話



タブレット



無人機



レコーダー



デジカメ



**最大1TBの容量/ 高速データ転送 /高解像度
ビデオストレージのため/ 多様なアプリケーションシナリオ**

- ・ 高解像度のビデオ録画、大容量ファイルの保存、拡張可能なストレージなど、個人や企業の爆発的に増加するデータストレージニーズへの対応を支援する。

U2000

USB2.0 フラッシュドライブ



▶製品仕様/Specification

モデル名	U2000 -8G	U2000 -16G	U2000- 32G	U2000- 64G	U2000- 128G
プロトコル	USB 2.0				
容量(GB)	8	16	32	64	128
読み取り性能(MB/s)	最大25				
書き込み性能(MB/s)	最大18				
サイズ	32.6mm x 12.9mm x 4.6mm				
重量	4.8g				
動作温度	-40°C ~ +70°C				
耐久性	5000回以上抜き差し				
互換性	Windows 7/8/8.1/10/11 Mac OS 10.9以降 Linuxカーネル2.6以降				

▶製品特徴/Product Features

- ・ U2000シリーズUSBフラッシュドライブは、クラシックなType-Aポート設計を採用し、USB 2.0プロトコルに対応し、プラグアンドプレイ機能を提供する。
- ・ 256GBから1TBまでの容量に対応している。
- ・ 初期不良品の無料交換を保証

・ポケットサイズのデザイン

U2000シリーズは、耐久性と高級感を高める金属製の外装を採用し、長さわずか32.6mmの超コンパクトサイズで、スペースを節約し、持ち運びや保管にも便利である。

▶製品仕様/Specification

モデル名	U3000-8G	U3000-16G	U3000-32G	U3000-64G	U3000-128G
プロトコル	USB 3.2 Gen1				
製品の外観	Type-AとType-Cの2in1				
容量	8GB	16GB	32GB	64GB	128GB
読み取り性能(MB/s)	最大120				
書き込み性能(MB/s)	最大50				
サイズ	65.6mm x 19.0mm x 9.6mm				
重量	14.8g				
動作温度	-40°C ~ +70°C				
耐久性	5000回以上抜き差し				
互換性	Windows 7/8/8.1/10/11 Mac OS 10.9以降 Linuxカーネル2.6以降				

U3000

USB3.2 多色フラッシュドライブ



▶製品特徴/Product Features

・デュアルポート プラグアンドプレイ

Type-AとType-Cのデュアルポート設計により、プラグアンドプレイ機能を実現する。

パソコンとスマートフォンの両方にシームレスに接続できる。

・高い互換性

USB3.2Gen1プロトコルをサポートし、プラットフォーム間で高速・簡単にデータを転送できる。

・柔軟な容量オプション

U3000シリーズは、8GBから128GBまでの容量をサポートする。オフィス文書を保存しても、超大型映画をコピーしても、スペースの要件を満たすことができる。

・カラフルな外観デザイン

さまざまな色から選択できるため、見た目をカスタマイズできる。

・初期不良品の無料交換を保証

U3500

USB3.2 高速フラッシュドライブ



▶製品仕様/Specification

モデル名	U3500-128G	U3500-256G
プロトコル	USB 3.2 Gen1	
製品の外観	Type-AとCの2in1	
容量	128GB	256GB
読み取り性能(MB/s)	最大400	最大500
書き込み性能(MB/s)	最大300	最大400
サイズ	67.9mm x 16.8mm x 10.0 mm	
重量	25g	
動作温度	-40°C ~ +70°C	
耐久性	5000回以上抜き差し	
互換性	Windows 7/8/8.1/10/11 Mac OS 10.9以降 Linuxカーネル2.6以降	

▶製品特徴/Product Features

・デュアルポート プラグアンドプレイ

Type-AとType-Cのデュアルポート設計により、プラグアンドプレイ機能を実現する。

パソコンとスマートフォンの両方にシームレスに接続できる。

・柔軟な容量オプション

U3500シリーズは専用のコントローラーと高速フラッシュメモリを使用し、最大 500MB/秒の速度をサポートし、待ち時間がなく、ファイル転送を超高速化できる。

・高い互換性

USB3.2Gen1プロトコルをサポートし、プラットフォーム間で高速・簡単にデータを転送できる。

・オールメタルの外装デザイン

U3500 シリーズは、オールメタルの外装と回転式のデザインも特徴としており、ポケットに簡単に収まり、外出中も優れたデータ保護を提供する。

・初期不良品の無料交換を保証

EM110

暗号化ポータブルSSD



▶製品仕様/Specification

モデル名	EM110	EM110F	EM110S
プロトコル	USB3.2 Gen2		
容量	256GB/512GB/1TB/2TB/4TB		512GB/1TB/2TB/4TB
コネクタ	USB Type-C		
サイズ	40x 74 x 8 mm		
重量	65g		
SED暗号化	○		
パスワードロック解除	○		
書き込み保護モード	○		
磁気	○		
指紋ロック解除	—	○	—
プライベート パーティション	—	—	○
防水性能	IP65		
落下耐性	2M		
動作温度	0° C~50° C		
システム互換性	Windows 11/10/8.1/7、Mac OS 10.11以降、Android、iOS PlayStation™ システムソフトウェア バージョン4.50以降		

▶製品特徴/Product Features

・高速伝送

USB3.2Gen2x1ポートを採用し、1050MB/sの転送速度を突破した。外付けHDDの約9.5倍の速さで、1TBのファイルを数分で転送できる。

・全プラットフォームでプラグアンドプレイ

Windows、macOS、Android、iOSに対応し、あらゆるシステムでプラグアンドプレイ機能をサポートし、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などのデバイスにシームレスに接続できる。

・全方位セキュリティ保護

SED（自己暗号化ハードドライブ）テクノロジーが標準搭載され、独立した暗号化チップを用いてデータをリアルタイムで暗号化し、データは書き込みと同時にロックされるため、第三者の復号(解読)は不可能である。

指紋認証ロック解除モジュールを搭載し、複数の指紋認証によるロック解除が可能で、ログ解錠時間は0.3秒以内で、従来のパスワード忘れのリスクを回避できる。

3年間の品質保証によるデータのセキュリティを守る。

免責声明

1. 本カタログに記載されている情報（メインコントロールチップのパラメータ、ソリッドステートドライブ、DDRモジュール、ポータブルストレージ製品の技術仕様などを含むが、これらに限定されない）は参考情報としてのみ提供されています。当社は、予告なしに技術調整および製品の最適化を行う権利を留保します。
2. 本カタログに記載されている製品データは、実験室でのテストに基づいています。実際の使用状況は、システム構成、温度条件、負荷の違いにより異なる場合があります。
3. 製品の外観、機能、付属品は実際の製品によって異なります。商標および特許は、当社およびそれぞれの権利者に帰属します。

発行日：2025年11月1日、有効期間：2026年10月30日。